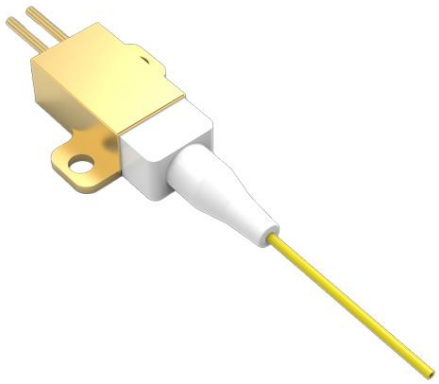
808nm 8W 光纤耦合半导体激光器

K808DB2RN-8.000WN0N-10522F10ESM（标准产品）



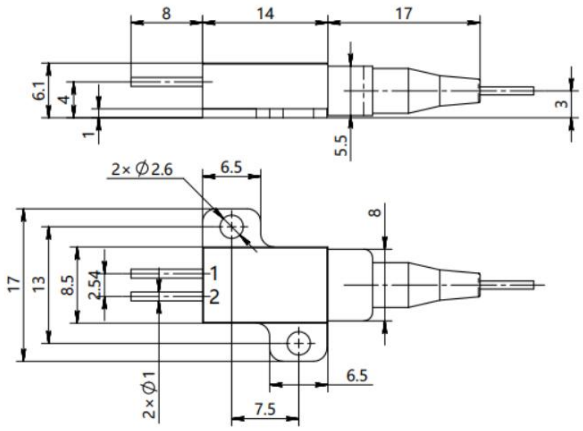
主要特性：

- 波长 808±3nm
- 出纤功率 8W
- 光纤芯径 105μm
- 光纤数值孔径 0.22 NA

应用领域：

- 固体激光器泵浦源
- 科学研究

外形尺寸（mm）



引脚	说明
1	激光器（+）
2	激光器（-）

使用说明

- 激光器工作时，避免激光照射眼睛和皮肤。
- 运输、储存、使用时必须采取防静电措施，运输和储存过程中引脚之间需连接短路线保护。
- 工作电流在 6A 以上的激光器请采用焊接方式连接引线，焊接点尽量靠近引脚中部，温度低于 260℃，焊接时间小于 10 秒。
- 在激光器工作前，确保光纤输出端已正确清洁。在处理和切割光纤时，请遵循安全协议以避免受伤。
- 使用恒流电源，工作时避免浪涌。
- 应在额定电流、额定功率下使用。
- 激光器工作时需保证良好散热。
- 工作温度 20℃~30℃。
- 存储温度 - 20℃~ + 70℃。



808nm 8W 光纤耦合半导体激光器

K808DB2RN-8.000WN0N-10522F10ESM（标准产品）

典型产品技术指标（25℃）		符号	单位	K808DB2RN-8.000W		
				最小值	典型值	最大值
光学参数 (1)	输出功率	P_O	W	8	-	-
	中心波长(2)	λc	nm	808±3		
	光谱宽度(FWHM)	Δλ	nm	-	3	7
	温漂系数	Δλ/ΔT	nm/℃	-	0.3	-
	电漂系数	Δλ/ΔA	nm/A	-	0.6	-
电学参数	电光效率	PE	%	-	48	-
	阈值电流	I_{th}	A	-	1.5	-
	工作电流	I_{op}	A	-	9.0	11.0
	工作电压	V_{op}	V	-	1.8	2.0
	斜率效率	η	W/A	-	1.0	-
光纤参数	光纤芯径	D_{core}	μm	-	105	-
	包层芯径	D_{clad}	μm	-	125	-
	数值孔径	NA	-	-	0.22	-
	光纤长度	L_f	m	-	1	-
	光纤护套	-	mm	-	0.9	-
	弯曲半径	-	mm	50	-	-
	光纤连接头	-	-	SMA905		
防反波段	防反波段		nm	1020-1200		
	隔离度		-	-	30	-
其他参数	ESD	V_{esd}	V	-	-	500
	存储温度(3)	T_{st}	℃	-20	-	70
	焊接温度	T_{ls}	℃	-	-	260
	焊接时间	t	sec	-	-	10
	工作温度(4)	T_{op}	℃	20	25	30
	相对湿度	RH	%	15	-	75

(1) 所有数据均在标称输出功率@25℃情况下测试；

(2) 请在非结露条件下存贮和使用；

(3) 工作温度指底板温度，可接受的使用温度范围 20℃~30℃，但是不同温度下性能可能略有差别。

声明：北京海普林光电科技有限公司所提供的产品信息是可靠、准确的，并有权随时对产品的设计和参数进行改进和修改，恕不另行通知。26-09